

組み込みボード

セットトレンド

- CPU/FPGA高性能化
→高速駆動
- DDRメモリー大容量化
- 医療/工作機器/FA機器

電源回路の動向

・負荷電流の増加

- ① CPU/FPGAコア電源
- ② DDR電源
- ③ システム電源
- ④ 電源入力ノイズ除去

キャパシタ 要求仕様

低ESR

小形

低背

高耐圧

推奨商品特長

SP-Cap

- 超低ESR(3mΩ~)
- 低背(1~2mm)



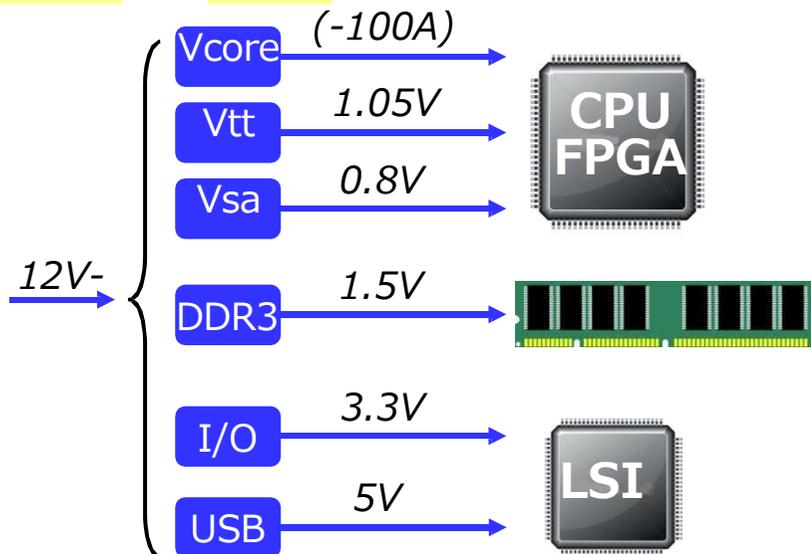
POSCAP

- 低ESR(5mΩ~)
- 小形化(3528)



入力

出力



	SP-Cap	POSCAP
CPU	2V470uF 3-6mΩ/Dsize	2.5V270uF 6mΩ/Bsize
DDR3	2V470uF 3-6mΩ/Dsize	2.5V330uF 9mΩ/Bsize
System (2V以下)	2V470uF 3-6mΩ/Dsize	2.5V330uF 15mΩ/Bsize
I/O USB	6.3V220uF 15mΩ/Dsize	6.3V220uF 25mΩ/Bsize
USB (5V)	-	16V100uF 50mΩ/Dsize